

Newsletter MHS Electronics

Nous avons le plaisir de vous présenter notre première Newsletter MHS Electronics ! Grâce à cette publication trimestrielle, nous vous informerons sur **nos nouveaux procédés et nouvelles technologies ainsi que sur nos services de fonderie de silicium**. Nous vous tiendrons au courant de la vie de MHS et de notre participation aux salons professionnels. Vous partagerez également avec nous l'actualité de nos équipes et bureaux de ventes internationaux. Bonne lecture !

Présentation de MHS Electronics



Si vous ne nous connaissez pas encore ! Filiale du groupe français MHS Industries, **MHS Electronics est un fournisseur clé en Europe de fonderie de silicium en technologies analogiques et à signaux-mixtes spécialisés**. Par l'acquisition, en février 2008, des actifs de l'activité fonderie analogique de Zarlink sise à Swindon au Royaume-Uni, la société a augmenté ses capacités de production et élargi son portefeuille technologique afin de servir les marchés de l'automobile, de l'espace, de la défense, des télécommunications et de la gestion d'alimentation, ainsi que ceux du médical et de l'industriel.

MHS Electronics a plusieurs décennies d'expérience dans la conception, la fabrication et la commercialisation des semi-conducteurs. Notre **offre de services en fonderie** repose sur des technologies bipolaires analogiques haute performance et des procédés signaux mixtes CMOS, BiCMOS et LDMOS spécialisés allant jusqu'au 0,35µm. Cette prestation existe aussi bien sur des substrats silicium que sur des substrats silicium sur isolant (SOI : Silicon-On-Insulator).

MHS Electronics à Santa Clara !



MHS Electronics est membre de GSA et participera au salon GSA Suppliers Expo & Conference qui se tiendra à Santa Clara le 2 octobre 2008.

Nous vous invitons à nous rendre visite sur notre stand n° 606/608. Notre équipe de ventes et marketing aura le plaisir de vous accueillir pour vous présenter MHS et son offre technologique dédiée à la Fonderie de Silicium.

MHS ouvre un bureau à Shanghai



Dans la périphérie de Shanghai, dans la zone d'activités technologiques de ZiZhu près de la célèbre rivière HuangPu, MHS vient d'ouvrir un nouveau bureau de ventes pour mieux répondre à la demande croissante du marché de l'Asie Pacifique. Steven Zhu (Dr), qui a récemment rejoint notre équipe de ventes ainsi que Sandra Chirk seront dans nos nouveaux locaux de Shanghai dès le mois de juillet pour Steven et courant octobre pour Sandra.

L'espace de travail sera doté de tous les équipements électroniques nécessaires ainsi que d'une salle de réunion pour recevoir nos clients et nos visiteurs. D'autres salles plus spacieuses, peuvent être réservées et utilisées au sein même de la zone d'activités pour des séminaires techniques ou de formation prévus dans le futur.

Ce bureau se trouve dans l'un des cinq immeubles nouvellement construits pour encourager l'implantation des start-ups locales issues des universités et les nouvelles entreprises arrivant sur le marché chinois, comme MHS. L'environnement nous permet également d'accéder aux plateformes logicielles de conception microélectronique.

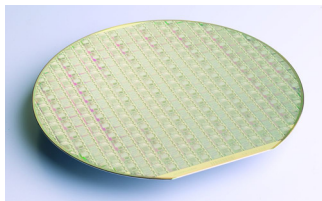
La zone d'activités est adjacente à deux universités, qui pourront nous apporter tout le support technique dont nous aurons besoin pour étendre notre activité dans la région.

A proximité de notre immeuble se trouvent de prestigieuses entreprises internationales comme Intel et Microsoft ainsi que plusieurs autres sociétés chinoises de haute technologie.

La zone technologique de ZiZhu est à 30 minutes de l'aéroport de HongQiao, à 45 minutes de l'aéroport de Pudong et à 30 minutes du centre de Shanghai. Elle est desservie par le réseau ferroviaire et il est question d'y étendre l'ensemble des transports publics.

Pour avoir plus d'informations sur l'accès à la zone d'activités et l'adresse postale du bureau à Shanghai, veuillez contacter Steven Zhu au +86 1 37 01 70 28 91.

MHS Electronics au Royaume Uni lance deux projets d'une durée de 3 ans, financés par le Comité Stratégique Technologique (TSB Technology Strategy Board)



PPM2

Intégration de composants passifs de précision dans les procédés de fabrication de Substrats Silicium et de Circuits Intégrés

Partenaires TWI (Leader), MHS-Electronics, Flomerics, JDS Designs, QUDOS, Université de Sheffield, Université de Leeds

PPM2 va permettre de concevoir et développer des technologies de fabrication de composants passifs pour les substrats de silicium et puces électroniques afin de fournir une gamme complète de résistances, condensateurs, inducteurs et autres composants de haute densité d'intégration. Ces technologies vont utiliser des procédés de fabrication originaux afin de garantir des niveaux de précision des composants passifs d'un ordre de grandeur supérieur aux procédés actuels. L'utilisation de substrats silicium à haute

conductivité thermique va apporter une réduction par dix de la résistance thermique des substrats. Les technologies seront caractérisées en termes de performance, de fiabilité et de coût par fonction et des design kits seront créés pour une conception sécurisée de circuits dans un délai optimisé de mise sur le marché. Les choix de conception et de fabrication seront validés par le biais de démonstrateurs de dispositifs et systèmes dans les domaines de la microélectronique à radio fréquence analogique pour la gestion d'alimentation et des dispositifs médicaux implantés.

HIVICS

Conception et fabrication de Circuits Intégrés à haute tension sur SOI (Silicon-On-Insulator) pour les applications automobiles

Partenaires MHS Electronics (Leader), Silvaco, Université de Sheffield, Université Queen's de Belfast

Les applications automobiles nécessitant une haute performance, des Circuits Intégrés optimisés allant jusqu'à 100 Volts font leur apparition. L'objectif de ce projet est de concevoir et développer un procédé de fabrication afin de répondre aux demandes contradictoires de forte isolation électrique, de gestion thermique et de haute densité de composants présentées par ces applications. Ce défi sera relevé grâce au travail qui consiste à incorporer de nouveaux substrats originaux SOI à basse résistance thermique et à y intégrer des architectures de dispositifs originales. Afin de s'attaquer à ces challenges d'ingénierie complexe, le projet inclura le nécessaire développement de simulations numériques de pointe en 3D, des améliorations par rapport aux modèles électriques comportementaux existants et le perfectionnement des outils de conception (CAO) existants. Des simulations probabilistes vont aussi être utilisées afin d'optimiser la manufacturabilité des composants haute-tension, et des véhicules d'évaluation de la technologie vont être réalisés afin de valider les modèles et simulations numériques. A l'issue de ce programme de développement, la nouvelle plateforme technologique à haute tension sur SOI sera proposée dans le cadre d'un service de fonderie de silicium aux clients PME situés en Angleterre bien sûr mais également dans l'ensemble de l'Europe, au Moyen-Orient et en Afrique qui conçoivent des circuits pour le marché automobile.